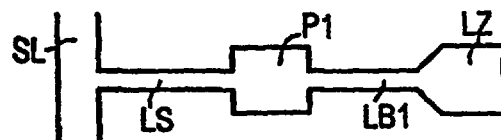


(51) International patent classification⁶: H05K 3/34, H01L 21/48	A1	(11) International publication number: WO 99/63795 (43) International publication date: 9 December 1999 (09.12.99)
(21) International application number: PCT/EP99/03802 (22) International filing date: 1 June 1999 (01.06.99) (30) Data relating to the priority: 198 24 633.1 2 June 1998 (02.06.98) DE (71) Applicant (for all designated States except US): SIEMENS S. A. [BE/BE]; Chaussee de Charleroi 116, B-1060 Brussels (BE). (72) Inventors; and (75) Inventors/Applicants (US only): ASCHENBRENNER, Rolf [DE/DE]; Unter den Eichen 57 c, D-12203 Berlin (DE). KLÖSER, Joachim [DE/DE]; Wartburgstrasse 53 a, D-10823 Berlin (DE). JUNG, Erik [DE/DE]; Flatowallee 16/836, D-14055 Berlin (DE). BOONE, Luc [BE/BE]; Karel de Stoutelaan 6, B-8020 Oostkamp (BE). DE STEUR, Hubert [BE/BE]; Treinstraat 1, B-9031 Drongen (BE). HEERMAN, Marcel [BE/BE]; Azaleastrasse 6, B-9200 Merelbeke (BE). VAN PUYMBROECK, Jozef [BE/BE]; Korenbloemstraat 17, B-8020 Oostkamp (BE). (74) Attorney: EPPING, Wilhelm; Siemens S.A., Postfach 22 13 17, D-80503 Munich (DE).		(81) Designated states: CN, JP, KR, SG, US, European Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Published With the International Search Report.

As printed

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING WIRINGS HAVING SOLDER BUMPS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON VERDRAHTUNGEN MIT LOTHÖCKERN



(57) Abstract

According to the invention, the conductor pattern is configured such that the connection pads (P1) are respectively connected via a conductor region with a reduced width (LB1) to the conductor tabs (LZ) which extend the conductor. A solder layer deposited on the conductor pattern is preferably remelted by a laser beam, whereby the solder flows up to the connection pads (P1) and forms solder bumps there.

(57) Zusammenfassung

Das Leitermuster wird so ausgestaltet, daß Anschluß-Pads (P1) jeweils über einen in der Breite reduzierten Leiterbereich (LB1) mit den weiterführenden Leiterzungen (LZ) verbunden sind. Eine auf das Leitermuster aufgebrachte Lötsschicht wird vorzugsweise mittels eines Laserstrahls umgeschmolzen, wobei das Lot zu den Anschluß-Pads (P1) hin fließt und sich dort Löthöcker bilden.